

72XX

全自动切割系统



7200系统提供各种高级自动化和过程监控功能,满足最严苛切割应用的生产量和质量要求:硅、硅玻璃、玻璃、BGA和QFN封装、LTCC、陶瓷、PCB和其他硬质材料应用。



- 高效的晶圆处理系统
- 刀片磨损预测算法,减少高度测量时间并增加每小时产出
- 连续数字放大视觉系统
- 雾化晶圆清洗技术,卓越的工艺效果

工件尺寸

7222

7223

7224

7200-300 2"

7200-300 4"

主轴

60K rpm/1.8kW

30K rpm/2.5kW

60K rpm/1.8kW

30K rpm/2.5kW

刀片尺寸

2"~3"

4"~5"

2"~3"

4"~5"

尺寸

965 × 1460 × 1700 (mm)

965 × 1460 × 1700 (mm)

重量

1200 kg

1350 kg

Y轴

控制器

线性编码器/Y轴

分辨率

0.1 μm

累积精度

1.5 μm

步进精度

1.0 μm

X轴

气动滑块

Z轴

重复精度

1.0 μm

最大行程

30 mm (2.188"刀片外径)

θ轴

4 arc-sec

旋转速度

350°

清洁台

清洁方法

完全冲洗和干燥循环

重复精度

100~2,000 rpm

行程

雾化清洁功能

电气

200~240VAC, 50-60Hz, 单相